

## < 参加者募集 >

日米半導体プログラム UPWARDS に基づく  
広島大学 サマースクール 2026 夏期滞在

夏休みに広島大学に 約 12 日間滞在し、自身の研究内容を議論しながら半導体について学ぶプログラムを実施します。参加を希望する方は、応募フォームから応募してください。滞在中の学費と経費は九大の旅費規程に則り、UPWARDS の寄附金で賄われる予定です。

Micron 財団および東京エレクトロンご支援の下、半導体人材育成を目的とした日米 UPWARDS (※) のプログラムを行っています。このプログラムには、日本の 5 大学 (東北大、東京科学大、名古屋大、広島大、九州大) と米国 6 大学 (University of Washington、Purdue University、Rochester Institute Technology、Rensselaer Polytechnic Institute、Virginia Tech、Boise State University) が参画しています。

### 記

- ・日 程 : 2026 年 7 月 21 日 (火) ~ 8 月 3 日 (月)
- ・場 所 : 広島大学 東広島キャンパス (広島県東広島市)
- ・内 容 : 平和学習と、半導体研究拠点 RISE (半導体集積科学研究所) での実践的トレーニングを組み合わせた学際的プログラム。Micron Japan 訪問。TEL 交流会。
- ・対 象 者 : 電気情報工学科 1 年 ~ 博士課程学生。  
応募者が多い場合は志望動機・面接等で選抜。  
女子の参加を強く推奨します。
- ・人 数 : 1 ~ 2 名
- ・滞 在 : 広島大学提供の宿泊施設
- ・参 加 費 : プログラムに含まれない現地食事代・課外活動費用については、参加者負担とする。  
なお、移動のための交通費及び宿泊費用は大学負担とする (一部立替が必要)。
- ・募集期限 : 2026 年 2 月 25 日 (水) **2026 年 3 月 9 日 (月)**
- ・応募 URL : <https://forms.gle/G7tQ8Tm13zNuPdZd9>



- ・問合先 : システム情報科学研究所 湯浅 (hiromi.yuasa@ed.kyushu-u.ac.jp)  
UPWARDS 事務局 (upwards@mag.ed.kyushu-u.ac.jp)